CCMicro			13 novembre 2025

Appareil	Spécificités	Lieux	Responsables
FEI Quanta450 + EDS Bruker	Source W, pression contrôlée et mode environnemental (< 2600 Pa), EDS Quantax Bruker SDD 30mm²	**ENSIACET**	Y. Thebault
MEB JEOL JSM6510LV	Source W, EDS Bruker 50mm2	**UT-Chimie 2R1 salle 1087 B**	Y. Borjon-Piron
MEB TESCAN VEGA3	Source W, EDS Oxford X-Max 50mm2	**UT-Chimie salle 17**	Y. Borjon-Piron
Métalliseur Quorum Q150R ES Plus	Métallisation Au, Au/Pd, Ag, C, Pt à mouvement planétaire. Mesure des épaisseurs par balance quartz	**UT-Chimie salle 17**	Y. Borjon-Piron
Pulvérisateur cathodique Edward S150B	Métallisation Ag	**UT-Chimie salle 17**	Y. Borjon-Piron
Pulvérisateur cathodique JEOL JFC1200	Métallisation Ag	**UT-Chimie 2R1 salle 1087 B**	Y. Borjon-Piron
Pulvérisateur cathodique Cressington	Métallisation Ag, Au, Pt. Mesure des épaisseurs par quartz.	**UT-Chimie salle 15**	M.-C. Barthelemy

D'autres équipements sont accessibles
au Centre de Microcaractérisation Raimond Castaing (UAR 3623)
https://ccarcastaing.cnrs.fr/spip.php?rubrique3